

2019年中国半导体制造装备行业分析报告- 行业规模现状与发展潜力评估

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国半导体制造装备行业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/456721456721.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章 半导体制造装备行业发展综述

1.1 半导体制造装备行业定义及分类

1.1.1 行业概念及定义

1.1.2 行业主要产品大类

1.2 半导体制造装备行业统计标准

1.2.1 半导体制造装备行业统计部门和统计口径

1.2.2 半导体制造装备行业统计方法

1.2.3 半导体制造装备行业数据种类

1.3 半导体制造装备行业供应链分析

1.3.1 半导体制造装备行业上下游产业供应链简介

1.3.2 半导体制造装备行业主要下游产业链分析

(1) 消费电子行业现状与需求分析

(2) 计算机与外设市场发展现状与需求分析

(3) 网络通信行业现状与需求分析

(4) 汽车电子行业现状与需求分析

(5) 电子专用设备行业现状与需求分析

(6) 仪器仪表行业现状与需求分析

(7) LED显示行业现状与需求分析

(8) 电子照明行业现状与需求分析

1.3.3 半导体制造装备行业上游产业供应链分析

(1) 芯片市场发展分析

(2) 金属硅市场发展分析

(3) 铜材市场发展分析

(4) 塑封料市场发展状况分析

第二章 半导体制造装备行业发展现状及趋势分析

2.1 中国半导体制造装备行业发展现状分析

2.1.1 中国半导体制造装备行业发展总体概况

2.1.2 中国半导体制造装备行业发展主要特点

2.1.3 2019年半导体制造装备行业规模及财务指标分析

(1) 2019年半导体制造装备行业市场规模分析

- (2) 2019年半导体制造装备行业盈利能力分析
- (3) 2019年半导体制造装备行业运营能力分析
- (4) 2019年半导体制造装备行业偿债能力分析
- (5) 2019年半导体制造装备行业发展能力分析
- 2.22019 -2019年半导体制造装备行业经济指标分析
 - 2.2.1 半导体制造装备行业主要经济效益影响因素
 - 2.2.22019 -2019年半导体制造装备行业经济指标分析
 - 2.2.32019 -2019年不同规模企业主要经济指标分析
 - 2.2.42019 -2019年不同性质企业主要经济指标分析
 - 2.2.52019 -2019年不同地区企业经济指标分析
- 2.32019 -2019年半导体制造装备行业供需平衡分析
 - 2.3.12019 -2019年全国半导体制造装备行业供给情况分析
 - (1) 2016-2019年全国半导体制造装备行业总产值分析
 - (2) 2016-2019年全国半导体制造装备行业产成品分析
 - 2.3.22019 -2019年全国半导体制造装备行业需求情况分析
 - (1) 2016-2019年全国半导体制造装备行业销售产值分析
 - (2) 2016-2019年全国半导体制造装备行业销售收入分析
 - 2.3.32019 -2019年全国半导体制造装备行业产销率分析
- 2.42019 年半导体制造装备行业发展现状分析
 - 2.4.12019 年行业产业规模分析
 - 2.4.22019 年行业资本/劳动密集度分析
 - 2.4.32019 年行业产销分析
 - 2.4.42019 年行业成本费用结构分析
 - 2.4.52019 年行业盈亏分析
- 2.52019 -2019年12月半导体制造装备行业进出口市场调研
 - 2.5.1 半导体制造装备行业进出口状况综述
 - 2.5.2 半导体制造装备行业出口市场调研
 - (1) 2016-2019年半导体制造装备行业出口市场调研
 - 1) 行业出口整体情况
 - 2) 行业出口产品结构分析
 - 3) 行业内外销比例分析
 - (2) 2019年行业出口市场调研
 - 1) 行业出口整体状况
 - 2) 行业出口产品结构特征分析
 - 2.5.3 半导体制造装备行业进口市场调研

(1) 2016-2019年半导体制造装备行业进口市场调研

1) 行业进口整体情况

2) 行业进口产品结构

3) 国内市场内外供应比例分析

(2) 2019年行业进口市场调研

1) 行业进口整体状况

2) 行业进口产品结构特征分析

2.5.4 半导体制造装备行业进出口前景及建议

(1) 半导体制造装备行业出口前景及建议

(2) 半导体制造装备行业进口前景及建议

2.6 2019 -2024年中国半导体制造装备行业趋势预测分析

2.6.1 半导体制造装备行业发展的驱动因素分析

(1) 市场空间较大，需求增长强劲

(2) 下游产业的推动

2.6.2 半导体制造装备行业发展的障碍因素分析

(1) 产品结构待完善

(2) 企业生产规模及所有制因素

(3) 成本压力增大

2.6.3 半导体制造装备行业发展趋势

2.6.4 2019 -2024年半导体制造装备行业趋势预测分析

第三章 半导体制造装备行业市场环境分析

3.1 行业政策环境分析

3.1.1 行业相关政策动向

(1) 《电子信息产业调整和振兴规划》

(2) 2019年全国半导体照明电子行业标准

(3) 《产业结构调整指导目录（2019年本）》

(4) 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2019年度）》

3.1.2 半导体制造装备行业发展规划

3.2 行业经济环境分析

3.2.1 国际宏观经济环境分析

(1) 国际宏观经济走势分析

(2) 国际宏观经济走势预测

3.2.2 国内宏观经济环境分析

(1) 国内宏观经济走势分析

- (2) 国内宏观经济走势预测
- 3.2.3 行业宏观经济环境分析
- 3.3 行业需求环境分析
 - 3.3.1 行业需求特征分析
 - 3.3.2 行业需求趋势分析
- 3.4 行业贸易环境分析
 - 3.4.1 行业贸易环境发展现状
 - 3.4.2 行业贸易环境发展趋势
- 3.5 行业社会环境分析
 - 3.5.1 行业发展与社会经济的协调
 - 3.5.2 行业发展的地区不平衡问题
 - 3.5.3 行业发展面临的环境保护问题

第四章 半导体制造装备行业市场竞争状况分析

- 4.1 行业总体市场竞争状况分析
- 4.2 行业国际市场竞争状况分析
 - 4.2.1 国际半导体制造装备市场发展状况
 - 4.2.2 国际半导体制造装备市场竞争状况分析
 - 4.2.3 国际半导体制造装备市场发展趋势分析
 - 4.2.4 跨国公司在中国市场的投资布局
 - (1) 日本厂商在华投资布局分析
 - 1) 东芝 (TOSHIBA)
 - 2) 瑞萨 (RENESAS)
 - 3) 罗姆 (Rohm)
 - 4) 松下 (Panasonic)
 - 5) 日本电气股份有限公司 (NEC)
 - 6) 三肯 (Sanken)
 - 7) 富士电机 (FujiElectric)
 - 8) 三洋 (Sanyo)
 - 9) 新电元 (ShindengenElectric)
 - 10) 富士通 (Fujitsu)
 - (2) 美国厂商在华投资布局分析
 - 1) 威旭 (Vishay)
 - 2) 飞兆半导体 (FairchildSemiconductors)
 - 3) 国际整流器公司 (InternationalRectifier)

- 4) 安森美 (OnSemiconductors)
 - (3) 欧洲厂商在华投资布局分析
- 1) 飞利浦半导体 (PhilipsSemiconductors)
- 2) 意法半导体 (STMiCROelectronics)
- 3) 英飞凌 (InfineonTechnologies)
- 4.2.5 跨国公司在华的竞争策略分析
- 4.3 行业国内市场竞争状况分析
 - 4.3.1 国内半导体制造装备行业竞争格局分析
 - 4.3.2 国内半导体制造装备行业集中度分析
 - (1) 行业销售集中度分析
 - (2) 行业利润集中度分析
 - (3) 行业工业总产值集中度分析
 - 4.3.3 国内半导体制造装备行业市场规模分析
 - 4.3.4 国内半导体制造装备行业潜在威胁分析
- 4.4 行业不同经济类型企业特征分析
 - 4.4.1 不同经济类型企业特征情况
 - 4.4.2 行业经济类型集中度分析

第五章 半导体制造装备行业主要产品分析

- 5.1 行业主要产品结构特征
 - 5.1.1 行业产品结构特征分析
 - 5.1.2 行业产品市场发展概况
 - (1) 产品市场概况及产量分析
 - (2) 产品发展趋势
- 5.2 行业主要产品市场调研
 - 5.2.1 功率晶体管产品市场调研
 - 5.2.2 光电二极管产品市场调研
 - 5.2.3 普通二极管产品市场调研
 - 5.2.4 普通三极管产品市场调研
 - 5.2.5 其他分立器件产品市场调研
- 5.3 行业主要产品技术与国外差距
 - 5.3.1 行业主要产品技术与国外的差距
 - 5.3.2 造成与国外产品差距的主要原因
- 5.4 行业主要产品新技术发展趋势
 - 5.4.1 国际半导体分立器件新技术发展趋势

5.4.2 国内半导体分立器件新技术发展趋势

第六章 半导体制造装备行业区域市场发展状况分析

6.1 行业区域市场总体发展状况分析

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.2 行业重点区域产销情况分析

6.2.1 华北地区半导体制造装备行业产销情况分析

(1) 2016-2019年北京市半导体制造装备行业产销情况分析

(2) 2016-2019年天津市半导体制造装备行业产销情况分析

(3) 2016-2019年河北省半导体制造装备行业产销情况分析

6.2.2 东北地区半导体制造装备行业产销情况分析

(1) 2016-2019年辽宁省半导体制造装备行业产销情况分析

(2) 2016-2019年吉林省半导体制造装备行业产销情况分析

(3) 2016-2019年黑龙江省半导体制造装备行业产销情况分析

6.2.3 华东地区半导体制造装备行业产销情况分析

(1) 2016-2019年上海市半导体制造装备行业产销情况分析

(2) 2016-2019年江苏省半导体制造装备行业产销情况分析

(3) 2016-2019年浙江省半导体制造装备行业产销情况分析

(4) 2016-2019年山东省半导体制造装备行业产销情况分析

(5) 2016-2019年安徽省半导体制造装备行业产销情况分析

(6) 2016-2019年江西省半导体制造装备行业产销情况分析

(7) 2016-2019年福建省半导体制造装备行业产销情况分析

6.2.4 华中地区半导体制造装备行业产销情况分析

(1) 2016-2019年湖北省半导体制造装备行业产销情况分析

(2) 2016-2019年湖南省半导体制造装备行业产销情况分析

(3) 2016-2019年河南省半导体制造装备行业产销情况分析

6.2.5 华南地区半导体制造装备行业产销情况分析

(1) 2016-2019年广东省半导体制造装备行业产销情况分析

(2) 2016-2019年广西半导体制造装备行业产销情况分析

6.2.6 其他地区半导体制造装备行业产销情况分析

(1) 2016-2019年四川省半导体制造装备行业产销情况分析

(2) 2016-2019年贵州省半导体制造装备行业产销情况分析

(3) 2016-2019年陕西省半导体制造装备行业产销情况分析

第七章 半导体制造装备行业主要企业生产经营分析

7.1 半导体制造装备商排名分析

7.1.1 半导体制造装备商工业总产值排名

7.1.2 半导体制造装备商销售收入排名

7.1.3 半导体制造装备商利润总额排名

7.2 半导体制造装备行业领先企业个案分析

7.2.1 深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

7.2.2 上海松下半导体有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

7.2.3 苏州松下半导体有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

7.2.4 无锡华润华晶微电子有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

7.2.5 恩智浦半导体广东有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业产销能力分析

(3) 企业盈利能力分析

(4) 企业运营能力分析

第八章 半导体制造装备行业投资分析及建议

8.1 半导体制造装备行业投资特性分析

8.1.1 半导体制造装备行业进入壁垒分析

- (1) 技术壁垒
- (2) 资金壁垒
- (3) 人才壁垒
- (4) 行业认证壁垒
- 8.1.2 半导体制造装备行业盈利模式分析
- 8.1.3 半导体制造装备行业盈利因素分析
 - (1) 市场需求持续增长，为半导体分立器件带来巨大市场空间
 - (2) 国家战略需求及对半导体产业政策大力扶持
- 8.2 半导体制造装备行业投资兼并与重组整合分析
 - 8.2.1 半导体制造装备行业投资兼并与重组整合概况
 - 8.2.2 外资半导体制造装备企业投资兼并与重组整合
 - 8.2.3 国内半导体制造装备企业投资兼并与重组整合
 - 8.2.4 半导体制造装备行业投资兼并与重组动向
- 8.3 半导体制造装备行业投资前景
 - 8.3.1 半导体制造装备行业政策风险
 - 8.3.2 半导体制造装备行业技术风险
 - 8.3.3 半导体制造装备行业宏观经济波动风险
 - 8.3.4 半导体制造装备行业关联产业风险
 - 8.3.5 半导体制造装备行业其他风险
- 8.4 半导体制造装备行业投资建议
 - 8.4.1 半导体制造装备行业投资机会分析
 - 8.4.2 半导体制造装备行业主要投资建议
 - (1) 培育核心竞争力，建立国际品牌
 - (2) 加快兼并和收购，尽快形成一批半导体分立器件行业的航母
 - (3) 加强半导体分立器件企业之间的联系和合作

图表目录

- 图表 2019年半导体制造装备行业产销情况（单位：万元，%）
- 图表 2019年半导体制造装备行业产销情况（按经济类型划分）（单位：万元，%）
- 图表 2019年半导体制造装备行业产销情况（按重点地区划分）（单位：万元，%）
- 图表 2019年半导体制造装备行业成本费用情况（单位：万元）
- 图表 2019年半导体制造装备行业成本费用结构情况（单位：%）

图表详见报告正文.....（GY YX）

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国半导体制造装备行业分析报告-行业规模现状与发展潜力评估》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/456721456721.html>